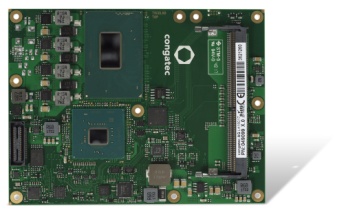
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Produktvorstellung

congatec COM Express Computer-on-Modules mit brandneuen  
Intel® Xeon® und Intel® Core™ Prozessoren der 8. Generation (Coffee Lake H)

**Leistungsstarker Sixpack von congatec für Type 6**

**Deggendorf, 3. April 2018** **\* \* \*** congatec – ein führender Anbieter standardisierter und kundenspezifischer Embedded Computer Boards und Module – stellt parallel zum Launch der 8. Generation der Embedded Intel® Xeon® und Intel® Core™ Prozessoren (Codename Coffee Lake H) seine brandneuen conga-TS370 COM Express Type 6 Computer-on-Module vor. Sie katapultieren die 35 bis 45 W TDP-Klasse der COM Express Type 6 Module auf das neue ‚Six-Pack‘-Level des High-End Embedded Computings, indem sie erstmals bis zu 6 Cores, 12 Threads und einen beeindruckenden Turbo-Boost von bis zu 4,4 GHz bieten sowie bis zu drei unabhängige 4k UHD-Displays unterstützen. Erste Tests von congatec zeigen, dass diese brandneuen Sechs-Kern Module im Vergleich zu Varianten mit der 7. Generation Intel® Core™ Prozessoren zwischen 45 bis 50 Prozent mehr Multithread- und 15 bis 25 Prozent mehr Singlethread-Performance bieten. Bei gegebener TDP erzielen Systementwickler damit eine höhere Bandbreite bei insgesamt geringerer Leistungsaufnahme, was letztlich die Systemeffizienz ultimativ steigert. Zielanwendungen sind leistungsstarke Embedded- und Mobil-Systeme, industrielle und medizinische Workstations, Storage-Server und Cloud-Workstations sowie Media-Transcoding- und Edge-Computing-Cores.

“Märkte wie die medizinische Bildgebung und Industrie 4.0 sowie Videoanalytik für beispielsweise Situational-Awareness und Transportüberwachung sind außerordentlich an jeder neuen Leistungssteigerung interessiert“, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec. „Mit unseren standardisierten Computer-on-Modules, Kühllösungen und eAPIs erleichtern wir die Nutzung dieser Leistungssteigerungen und machen Upgrades auf neueste Prozessorgenerationen mehr oder weniger zu einer reinen Plug&Play Aufgabe.“

Neben ihren Leistungssteigerungen überzeugen die neuen congatec Module insbesondere durch ihre hohe Langzeitverfügbarkeit von mindestens 10 Jahren, ihren bandbreitenstarken I/Os mit 4x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) und Intel® Optane™ Memory Support sowie den erweiterten Sicherheitsfeatures mit Intel® Software Guard Extensions, Trusted Execution Engine und Intel® Platform Trust Technology.

**Das Featureset im Detail**

Die neuen conga-TS370 COM Express Basic Type 6 Computer-on-Module sind mit Sechs-Kern Intel® Xeon® und Intel® Core™ i7 Prozessoren oder Quad-Core Intel® Core™ i5 Prozessoren in einem cTDP-Bereich von 35 bis 45 Watt sowie bis zu 32 GB DDR4 2666 Arbeitsspeicher verfügbar, optional mit ECC. Die integrierte Intel® UHD630 Grafik unterstützt bis zu drei unabhängige 4k-Displays mit bis zu 60 Hz via DP 1.4, HDMI, eDP und LVDS. Erstmalig können Entwickler nun auch ohne Hardwareänderungen rein über Software zwischen eDP und LVDS umschalten. Zudem zeichnen sich die Module durch ihre bandbreitenstarken I/Os aus. Dazu zählen 4x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), 8x USB 2.0 sowie 1x PEG und 8x PCIe Gen 3.0 Lanes für leistungsfähige Systemerweiterungen einschließlich Intel® Optane™ Memory. Die Module unterstützen alle gängigen Linux Betriebssysteme sowie die 64 bit Versionen von Microsoft Windows 10 und Windows 10 IoT. Ein persönlicher Integrationssupport der Premiumklasse zusammen mit umfangreichem Zubehör sowie standardisierten oder kundenspezifischen Carrierboard- und Systemdesigns runden das Leistungspaket der neuen Module ab.

Die neuen conga-TS370 COM Express Type 6 Computer-on-Modules können in folgenden Standardkonfigurationen bestellt werden:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores/ Threads** |  | **Takt [GHz] (Base/Boost)** |  | **Cache (MB)** |  | **TDP / cTDP [W]** |
| Intel® Xeon®  E-2176M |  | 6 / 12 |  | 2.7 / 4.4 |  | 12 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i7-8850H |  | 6 / 12 |  | 2.6 / 4.3 |  | 9 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i5-8400H |  | 4 / 8 |  | 2.5 / 4.2 |  | 8 |  | 45 / 35 |

Weitere Informationen zu dem neuen COM Express Type 6 Hochleistungsmodul conga-TS370 unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-ts370.html>

**Über congatec**

congatec ist ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und Customizing-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Xeon, Core und Optane sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*